

# 千住无铅锡膏S 70G、上海千住锡膏、焊锡膏

产品名称	千住无铅锡膏S 70G、上海千住锡膏、焊锡膏
公司名称	苏州耀佳机电设备有限公司
价格	650.00/公斤
规格参数	型号:千住S70G无卤锡膏 粘度:190 ( Pa · S ) 颗粒度:39 ( um )
公司地址	暂无
联系电话	86 0512 66797652

## 产品详情

型号	千住S70G无卤锡膏	粘度	190 ( Pa · S )
颗粒度	39 ( um )	品牌	日本千住
规格	0.5kG	合金组份	su-ag
活性	高RA	类型	免洗型
清洗角度	免洗型	熔点	217 ° ~250 °

home > 產品介紹 > eco solder > eco solder paste s70g

## eco solder paste s70g

eco solder paste

千住金屬所開發出之無鉛錫膏「eco solder paste」比較之前的錫膏，是針對於無鉛化所產生的問題，如保存安定性、供錫安定性、潤濕性及高融點之耐熱性等問題，都能得到解決之新世代環保錫膏。

eco solder paste s70g：新製品

維持了舊產品grn360系列印刷時的黏度安定性，更提升了耐熱性、flux飛散抑制、高信賴性的實裝品質、及生產性的綜合新產品。

大幅改善了bga融合不良的抑制力，且實裝後可直接檢查電路等。

改良的問題備詳細實裝課題和s70g的效果實裝品質生產容易發生的bga bump潤濕性不良、bga電極（焊接凸			
--	--	--	--

		塊)的氧化、零件彎曲、paste活性不足。s70g可以根本地解決以往grn360系列的問題。		
底面電極void		對於底面電極零件容易發生void問題，s70g和grn360系列相比約多了1/2的抑制效果。		
flux飛散		對於flux飛散造成連接端等接續異常，s70g和grn360系列相比成功地削減50~80%。		
潤濕性不良		使用大氣迴焊造成的氧化、flux活性的損失為主要潤濕性惡化的原因，容易造成大面積land的問題。s70g比起grn360系列帶來更良好的焊接潤濕性。		
使用壽命（版上的酸化）		s70g和grn360系列除了同樣可保證長時間印刷之外，其印刷作業中焊材粉末的氧化抑制、更加穩定、且減少廢棄損失。		
印刷停止後轉寫率低下		停止作業後，再啟動時印刷量安定性沒問題。s70g在停止前後可確保安定的轉寫性。		
實裝後的電路檢查		s70g殘留在焊材上的flux極少，可快速正確地進行電路檢查。		

頂層焊材粉末 solder paste s70g試驗	方法	合金組成 ag3.0-cu0.5-sn殘 ( m705 )	-
	溶融溫度	固相線溫度 217 pitch溫度 (液相線) 219	dsc示 差熱 分析 儀
	粉末形狀	球形	sem電 子顯 微鏡
	焊材粉末粒徑	type3 : 25?45 μ m type4 : 25 ?36 μ m type5 : 15?25 μ m	sem及 雷射 法
flux	flux typeflux 活性度	rol0	j-std-0 04j-std -004
	鹵素	溴 (br) 系0.02%以下 (本 產品不是無鹵素錫膏)	電位 差滴 定 (fl ux單

			獨測定)
	表面絕緣抵抗試驗 ( 40c90%rh,168hr )	over 1.0e+12	jis z 3284
	遷移試驗 ( 85c85%rh bias dc45v, 1000hr )	over 1.0e+9未發生遷移	jis z 3284
	銅鏡試驗	pass	jis z 3197
	氟化物試驗	pass	jis z 3197
ソルダペースト	黏度	190pa.s	jis z 3284
	搖變性指數	0.65	jis z 3284
	flux含有量	11.5%	jis z 3197
	熱坍塌特性	0.3mm以下	jis z 3284
	黏著性/保持時間 ( 1.0n以上 )	1.3n/24h以上	jis z 3284
	銅板腐蝕試驗	合格	jis z 3197
	保存期限 ( 冷藏:0 ~ 10c未開封 )	6個月	-

適用型號	連接器腳等零件	type3s70g type4s70g type5	0.5?0.4mm pitch	0.3mmpitch
	bga, lga等底面電極零件	> 0.65mm pitch	0.65?0.5mm pitch	0.4?0.3mm pitch
	chip零件size ( mm表示 )	> 1608?1005	1005?0603	0402

實裝密度/ pitch、零件尺寸

使用粉末sem 照片

type 3 粉末 ( 25?45 μ m )

type 4 粉末 ( 25?36 μ m )

type 5 粉末 ( 15?25 μ m )

您對任何品質問題、生產率提升對策等有疑問的地方，請務必提出討論。  
使用合金為m705 ( sn-3.0ag-0.5cu ) 為主的snagcu系合金，也歡迎詢問其他相關合金組成。